

证券代码：301095

证券简称：广立微

# 杭州广立微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 线上交流 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	易方达、诺安基金、银河基金、银华基金、国寿资产、永赢基金、金信基金、宝盈基金、中信证券、华泰证券、中金公司、中信建投、华源证券、山西证券、广发证券、国金证券、中泰证券、长江证券、民生证券、国投证券、国泰海通证券、Manulife、Oasis、Pinpoint Asset Management Limited、Rime Capital、上海东巍私募基金管理有限公司、SDIC Fund Management Co., Ltd. - Wei ZHANG、上海和谐汇一资产管理有限公司、上海景林资产管理有限公司、华能贵诚信托有限公司、招商证券资产管理有限公司等 31 家机构
时间	2026 年 1 月 1 日-2026 年 3 月 20 日
地点	现场交流、公司会议室
形式	现场会议、线上交流
公司接待人员	董秘兼财务总监：陆春龙 证券事务代表：李妍君
交流内容及具体问答记录	<b>一、公司概况</b>  广立微是领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备供应商，公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术，是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。公

司现已形成 EDA 设计软件、WAT 测试设备及半导体数据分析工具相结合的成品率提升全流程解决方案，在集成电路从设计到量产的整个产品周期内实现芯片性能、成品率、稳定性的提升。

## 二、问答环节

### 1、公司的晶圆级电性测试设备的核心竞争力在哪些方面？ 公司对品类拓展是如何布局的？

在市场竞争力方面，公司自主研发并已掌握了晶圆级电性测试设备（WAT）的并行测试技术以及片内测试加速方法等业界领先的关键核心技术，这不仅使产品实现了高质量的国产替代，更具备了国际水平的市场竞争力，并在国内头部晶圆厂中得到规模化应用与深度替代。

品类拓展方面，公司将持续保持高研发投入，在不断提升产品性能的同时，加速推进产品矩阵的拓展。目前，公司已将测试领域拓展至 WLR（晶圆级可靠性测试）和 SPICE，除了已推出的 WAT 测试机产品和 WLR 可靠性测试机产品外，还拓展了更多的测试设备品类，包括晶圆级老化测试设备、高压测试设备等，将应用场景从传统硅基向第三代化合物半导体扩展，助力更多车规级、高性能芯片测试需求。

### 2、公司去年收购了硅光设计软件企业 LUCEDA，并联合高校开展硅光测试设备的研发。请问公司在硅光领域的战略考量是什么？未来将如何与公司现有业务产生协同效应？

随着人工智能（AI）大模型及高性能计算的爆发式发展，传统采用铜线互连的模式在带宽、功耗、延迟上正面临着严峻的物理瓶颈，光电共封装（CPO）及硅光技术已成为了当下突破算力传输瓶颈的重要方向。

在此产业背景下，公司顺势进行了硅光技术的前瞻性布局。LUCEDA 在硅光芯片设计自动化软件领域拥有全球领先的技术储备，能够为客户提供光电子集成芯片设计、仿真、PDK 搭建及运维的全流程软件和服务，收购 LUCEDA，正是公司在硅光产业

	<p>布局的核心锚点,实现了公司业务从传统 EDA(电子设计自动化)到 PDA(光子设计自动化)的战略拓展。</p> <p>未来,公司将结合自身在半导体制造 EDA 工具和良率提升解决方案上的深厚积累,依托 LUCEDA 在硅光芯片设计领域的前沿技术,开展深度协同创新。目标是构建“硅光芯片设计-制造闭环”的软硬件协同优化平台,逐步打造出覆盖硅光芯片设计、制造、测试、及良率提升全链路的系统性解决方案,为公司培育强劲的第二增长曲线。</p> <p><b>3、近期 AI 技术的爆火,各类大模型技术也是不断更新迭代,请问这一波 AI 科技浪潮,对公司有何影响?公司产品是否有应用 AI 技术?</b></p> <p>AI 大模型及开源生态的繁荣,驱动了全球 AI 算力基础设施的建设,释放了对高性能计算芯片的庞大市场需求,同时对公司产品形态、研发模式和开发效率产生了深刻影响。</p> <p>近年来公司在 AI 技术布局上已经取得了显著的进展。在产品侧,公司 INF-AI 工业智能化集成平台发布,其中 INF-ADC 自动缺陷分类系统功能迭代,支持多种复杂业务场景,客户数量显著提升;推出 INF-WPA 晶圆缺陷图案分析系统、iCASE 半导体缺陷异常智能化诊断系统,已在客户处部署使用;DFT 良率分析工具 QuanTest-YAD 深度融合 AI 算法,实现了全流程数据的失效根因分析,并已在行业头部晶圆厂(Fab)完成功能和性能的双重认证。在大模型侧,公司半导体大模型平台 SemiMind 深度融合了知识库与智能体大模型技术,致力打造开放、灵活、可拓展的智能研发生态系统。</p> <p>综上,新一轮的 AI 科技浪潮既为公司拓展了广阔的增量市场,也为公司自身产品的技术迭代提供了强大的底层引擎。公司将紧抓这一历史性机遇,实现高质量发展。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披</p>	<p>无。</p>

露重大信息的说明	
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无。
日期	2026年3月23日